

KLA 推出全新突破性的电子束缺陷检测系统

加利福尼亚州米尔皮塔斯市，2020 年 7 月 20 日/-今天 [KLA 公司](#)（纳斯达克股票代码：[KLAC](#)）宣布推出革命性的 [eSL10™](#) 电子束图案化晶圆缺陷检查系统。该系统具有独特的检测能力，能够检测出常规光学或其他电子束检测平台无法捕获的缺陷，从而加速了高性能逻辑和存储芯片的上市时间（包括那些依赖于极端紫外线（[EUV](#)）光刻技术的芯片）。[eSL10](#) 的研发是始于最基本的构架，针对研发生产存在多年的问题而开发出了多项突破性技术，可提供高分辨率，高速检测功能，这是市场上任何其他电子束系统都难以比拟的

[KLA 电子束部门总经理 Amir Azordegan](#) 表示：“利用单一的高能量电子束，[eSL10](#) 系统将电子束检测性能提升到了一个新水平。”，“在此之前，电子束检测系统不能兼顾灵敏度和产能，严重限制了实际的应用。我们优秀的研发工程团队采用了全新的方法来设计电子束架构以及算法，研制出的新系统可以解决现有设备无法解决的问题。目前，[KLA](#) 将电子束检测列入对制造尖端产品至关重要的设备清单。”

[eSL10](#) 电子束检测系统具有多项革命性技术，能够弥补对关键缺陷检测能力的差距。独特的电子光学设计提供了在业界相对比较广泛的操作运行范围，能够捕获各种不同层和器件类型中的缺陷。[Yellowstone™](#) 扫描模式每次可以扫描收集 100 亿像素的信息，支持高速运行的同时不会影响分辨率，以在较大区域内也能高效地研究潜在弱点，实现缺陷发现。[Simul-6™](#) 传感器技术可以通过一次扫描同时收集表面、形貌、材料对比度和深沟槽信息，从而减少了在具有挑战性的器件结构和材料中识别不同缺陷类型所需的时间。[凭借其先进的人工智能（AI）系统](#)，[eSL10](#) 运用了深度学习算法，能满足 IC 制造商不断发展的检测要求，杜绝了对器件性能影响最关键的缺陷。

三维器件结构，例如用于内存应用的 3D NAND 和 DRAM，以及用于逻辑器件的 FinFET 和 GAA（Gate-All-Around）结构，都要求晶圆厂重新考虑传统的缺陷控制策略。[eSL10](#) 与 [KLA](#) 的旗舰 [39xx](#)（“[Gen5](#)”）和 [29xx](#)（“[Gen4](#)”）宽光谱晶圆缺陷检测系统的结合，为先进的 IC 技术提供了强大的缺陷发现和监测解决方案。这些系统共同合作，提高了产品的良率和可靠性，将更快地发现关键缺陷，并能够更快地解决从研发到生产的缺陷问题。

新推出的 [eSL10](#) 系统平台具有独特的扩展性，可以延伸到整个电子束检测和量测应用中。全球范围内先进的逻辑器件、存储器和制程设备制造商都在使用 [eSL10](#) 系统，利用该系统帮助研发生产过程，提升和监测下一代产品制程和器件的制造。为了保持其高性能和生产表现，[eSL10](#) 系统拥有 [KLA 全球综合服务网络的支持](#)。更多关于全新电子束缺陷检测系统的其他信息，请参见 [eSL10 产品页面](#)。



关于 KLA:

KLA Corporation 开发行业领先的设备和服务，实现整个电子行业的创新。我们提供先进的制程控制和支持解决方案，用于制造晶圆和掩模版、集成电路、封装、印刷电路板和平板显示器。通过与全球领先的客户紧密合作，汇聚我们的优秀团队，物理学家、工程师、数据科学家和问题解决专家们一起，创造开发推动世界技术前进的解决方案。相关更多信息，请访问 kla.com (KLAC-P)。

前瞻性声明:

除历史事实外，本新闻稿中的陈述是前瞻性陈述，例如关于 eSL10、29xx 和 39xx 系统的预期性能以及减少晶圆、设备、材料和芯片制造设施的缺陷所产生的经济影响的陈述，受《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的前瞻性声明免责保护。这些前瞻性陈述基于当前的信息和预期，并涉及风险和不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题还是其他原因），其他公司推出竞争产品或意外的技术挑战或局限性，实际结果可能与此类声明中的预期结果产生重大出入。会影响 KLA 产品的实施，性能或使用。

信息垂询 KLA Corporation

投资者关系: Kevin Kessel, CFA, 投资者关系副总裁 (408) 875-6627,
kevin.kessel@kla.com ;

媒体关系: Randi Polanich, 副总裁, 首席传讯官, (408) 875-6633
randi.polanich@kla.com